

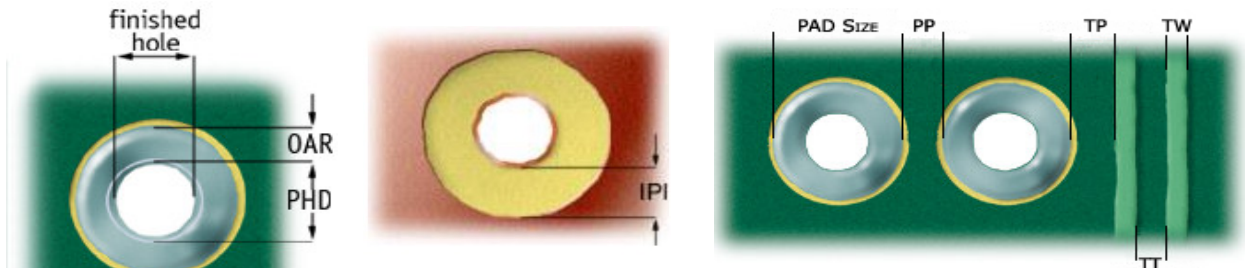


Eurocircuits - Leiterplatten-Klassifikationstabelle

Leiterbildklasse	Klasse 3		Klasse 4		Klasse 5		Klasse 6		Klasse 7		Klasse 8		Klasse 9		Klasse 10		
Service	P+S+R+I		P+S+R+I		P+S+R+I		P+S+R+I		S+R		S+R		S+R		-		
OTW	0,250	10	0,200	8	0,175	7	0,150	6	0,125	5	0,100	4	0,090	3,5	<0,090	<3.5	mm-mil
OTT-OTP-OPP	0,250	10	0,200	8	0,175	7	0,150	6	0,125	5	0,100	4	0,090	3,5	<0,090	<3.5	mm-mil
OAR	0,200	8	0,150	6	0,150	6	0,125	5	0,125	5	0,100	4	0,100	4	<0,100	<4	mm-mil
ITW	0,250	10	0,200	8	0,175	7	0,150	6	0,125	5	0,100	4	0,090	3,5	<0,090	<3.5	mm-mil
ITT-ITP-IPP	0,250	10	0,200	8	0,175	7	0,150	6	0,125	5	0,100	4	0,090	3,5	<0,090	<3.5	mm-mil
IAR	0,200	8	0,150	6	0,150	6	0,125	5	0,125	5	0,125	5	0,125	5	<0,125	<5	mm-mil
IPI	0,275	11	0,225	9	0,225	9	0,200	8	0,200	8	0,200	8	0,200	8	<0,200	<8	mm-mil

Der kleinste Wert (OTW, OTT-OTP-OPP, OAR, ITW, ITT-ITP-IPP, IAR) bestimmt die **Leiterbildklasse**

Basiskupfer		Minimalwerte					
Basis Cu OL		OTT-OTP-OPP		OTW			
12µm	½oz	0,090	3,5	0,090	3,5	mm-mil	
18µm	½oz	0,125	5	0,090	4	mm-mil	
35µm	1oz	0,200	8	0,125	5	mm-mil	
70µm	2oz	0,250	10	0,200	8	mm-mil	
105µm	3oz	0,300	12	0,250	10	mm-mil	
Basis Cu IL		ITT-ITP-IPP		ITW			
12µm	½oz	0,090	3,5	0,090	3,5	mm-mil	
18µm	½oz	0,100	4	0,090	4	mm-mil	
35µm	1oz	0,150	6	0,125	5	mm-mil	
70µm	2oz	0,250	10	0,200	8	mm-mil	
105µm	3oz	0,300	12	0,250	10	mm-mil	



vorangestellte Buchstaben **O** und **I** stehen für (Outer-) und (Inner layer)
 Beispiel: **OTW** = Outer layer **T**rack **W**idth (Aussenlagen-Leiterbahnbreite)

OAR : kleinster **OAR** (Outer layer Annular Ring = 1/2 (Outer layer pad diameter - PHD))

IAR : kleinster **IAR** (Inner layer Annular Ring = 1/2 (Inner layer pad diameter - PHD))

IPI (Innenlagen Pad Isolation): Freistellung zwischen Rand **PHD** jeglicher nicht-angebundener Bohrung (PTH/NPTH) und der nächsten Kupferfläche

kleinster **PHD**: Production Hole Diameter oder Werkzeugdurchmesser = Endlochdurchmesser + 0,10mm/4mil für durchkontaktierte Löcher (DK/PTH)
 + 0,00mm/0mil für nicht durchkontaktierte Löcher (NDK/NPTH)

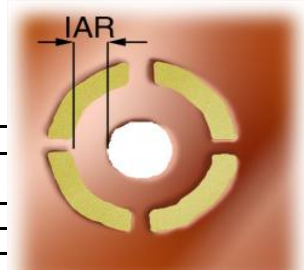
Bohrklasse	Klasse A		Klasse B		Klasse C		Klasse D		Klasse E		Klasse F		
Service	P+S+R+I		P+S+R		P+S+R		S+R		S+R		-		
min PHD	0,60	0,026	0,45	0,018	0,35	0,014	0,25	0,010	0,20	0,008	<0,20	<0,008	mm-inch



entsprechender Enddurchmesser

PTH	0,50	0,022	0,35	0,014	0,25	0,010	0,15	0,006	0,10	0,004	<0,10	<0,004	mm-inch
NPTH	0,60	0,026	0,45	0,018	0,35	0,014	0,25	0,010	0,20	0,008	<0,20	<0,008	mm-inch

Der kleinste Wert (PHD) bestimmt die **Bohrklasse** der Leiterplatte



Max. LP-Dicke	3,20		0,125		3,20		0,125		2,40		0,093		2,00		0,079		1,60		0,062		mm-inch		Aspect ratio ist 1 / 8	
---------------	------	--	-------	--	------	--	-------	--	------	--	-------	--	------	--	-------	--	------	--	-------	--	---------	--	------------------------	--

Anm. A: Via-Bohrungen sind DK-Bohrungen, standardmäßig definiert als ≤ 0,45mm (18mil) für sämtliche Services, oder ≤ X (X = durch den Kunden in den Bestell-Details vorgegeben).

Via-Bohrungen haben eine maximale negative Toleranz von 0,30mm (12mil)

Anm. B: Diese Klassifikationstabelle kann nur auf Leiterplatten-Designs angewendet werden, die einen Galvano-Index von 0,40 oder höher besitzen. Dieser Wert wird durch den PCB Visualizer® berechnet und angezeigt

Services Index : **P** = PCB proto **S** = STANDARD pool **R** = RF pool **I** = IMS pool